

2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券 在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司发行的 2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券将于 2019 年 11 月 11 日起在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券
债券简称	19 梁平债
债券代码	152312
信用评级	主体评级 AA，债项评级 AAA
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	153312
发行总额（亿元）	8
债券期限	7 年
票面年利率（%）	7.20
利息种类：	固定利息
付息频率：	按年付息
发行日：	2019 年 10 月 30 日—2019 年 10 月 31 日
起息日：	2019 年 10 月 31 日
上市日：	2019 年 11 月 11 日
到期日：	2026 年 10 月 31 日
发行价格：	100 元

（此页无正文，为《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

（盖章）



2019 年 11 月 1 日

（此页无正文，为《2019 年重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司公司债券在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

承销机构：华西证券股份有限公司
(盖章)



2019 年 11 月 1 日